

深圳市英唐智能控制股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	东北证券、平安基金、诺安基金、博时基金、西藏昱皓荣创投、华安证券、恒泽资产管理有限公司、绍兴优盛投资
时间	2025年11月28日、2025年12月1日
地点	线下路演交流：公司会议室
接待人员姓名	英唐智控董事长：胡庆周先生 英唐智控董事会秘书：李昊先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、基本情况介绍 公司董事长胡庆周先生为投资者介绍了英唐智控的发展历程及发展现状，英唐智控深耕电子元器件分销，构建全球多区域网络，覆盖主芯片、存储、射频、显示驱动、功率/模拟器件、MEMS传感器及被动器件等全品类，积累了丰富的客户资源。自研芯片聚焦MEMS微振镜与车载显示芯片，通过加大研发投入、引进高端人才实现技术突破。公司已在多家头部屏厂成功导入车载显示芯片业务，首款车规级TDDI/DDIC的量产落地，多款改进型产品也在按计划推进流片、试产中。 近期筹备并购桂林光隆集成与上海奥简微电子，旨在强化光通信芯片、模拟集成电路领域布局，与现有分销及自研业务形成协同效应，借助生成式AI、大模型训练及云计算的爆发式发展，OCS市场有望迎来更大的发展机遇，明确未来将构建以光、电、算技术闭环为核心的芯片设计制造企业，加速构建半导体全产业链能力。 二、提问交流环节

	1. 公司主营业务情况如何？ 答：公司分销业务稳健发展，芯片设计制造业务持续投入中。公司前三季度公司研发费用同比增长 90.06%，核心是加码显示芯片投入, 主要包括引进人才组建高素质研发团队，并在技术、项目验证上加大资金倾斜。短期内研发投入会对利润规模产生影响，长期将为业绩增长蓄能。 公司自研芯片业务方面，车载显示芯片业务已在多家头部屏厂成功导入芯片业务，首款车规级TDDI/DDIC的量产落地，多款改进型产品也在按计划推进流片、试产中；MEMS微振镜方面，其中4mm规格的MEMS微振镜产品进入市场。近期公司与欧摩威签署《战略合作框架协议》，基于LBS车载智能光应用商业化落地和未来发展，欧摩威拟将其LBS项目的MEMS芯片的定制开发以及模组生产等工作交由公司完成。 2. 针对车载显示芯片市场，公司的优势体现在哪里？消费类显示芯片项目进度如何？ 答：目前国内车载显示驱动芯片的绝大部分市场被台湾、韩国厂商占据，相比之下公司更加具备本地化优势，且公司车载显示芯片业务的研发团队技术储备深厚，可提供更加具备竞争力的产品。 公司的车载显示芯片部分已实现量产，改进型版本的车规级显示芯片也处于流片、试生产阶段。面向消费电子领域的OLED DDIC产品研发也取得阶段性进展，该产品已完成研发设计，顺利进入流片阶段，并有望在2026年一季度之前实现量产。 相较于本土厂商，公司处于致力于车载显示芯片国产替代的前沿，在市场布局上具备先发优势，在核心技术研发与应用层面也拥有更为突出的技术优势。公司将通过继续开发本土供应链体系，为公司建立更具有竞争力的产品体系，实现市场份额的提升。 3. 公司芯片设计制造业务的收入主要来自哪些产品？ 答：目前公司芯片设计制造业务的收入主要来自子公司日本英唐微，产品主要集中在光电传感器，数字信号接收芯片等，相关产品已形成稳定的市场和销售收入。公司自研车载显示芯片、MEMS微振镜部分规格已逐步迈入市场推广及应用阶段，与此同时，改进型产品也在积极研发过程中，公司将根据市场需求和技术发展趋势，不断丰富和优化芯片产品矩阵，为公司芯片设计制造业务的可持续发展奠定坚实基础。
--	---

	4. 公司本次拟发行股份购买资产，与标的之间有哪些协同效应？ 答：公司深耕电子元器件分销行业多年，各产品线毛利水平整体与市场趋势保持一致。在部分细分产品领域，受行业竞争格局及市场供需关系动态调整等因素影响，面临一定的盈利空间优化压力。近几年公司一直在加大资源投入，发展芯片设计制造业务，开发更高附加值产品，谋求业绩新增长点。 在MEMS微振镜领域，公司拥有完整的MEMS生产线，光隆集成始终专注于光开关相关技术研发，在机械式、MEMS微机械式、磁光式、电光式及波导式等多种控制方式上均有长期布局。在MEMS技术的OCS(光路交换机)系统布局多年，双方计划尽快在MEMS阵列产品的技术及制造层面实现共享互补，加速相关产品的量产进程。 上海奥简微电子专注于模拟芯片与混合信号芯片设计，公司近几年在车载显示芯片（DDIC/TDDI）领域研发投入加码，包括引进高素质研发团队，在技术、项目验证等方面加大投入等。上海奥简微电子的模拟技术有望加强公司显示驱动产品的高速接口能力以及触控驱动产品的模拟AFE能力。通过此次并购可加速推进国内自有研发团队的组建，充分整合国内优秀人才资源，提升研发创新能力，融合海外产品、技术，使产品研发更贴合国内市场需求，缩短产品上市周期。 5. 重组业务的进展如何？标的公司估值是多少？ 答：公司以及有关各方正在积极推进本次交易相关的审计、评估工作。具体估值以审计评估结果为准。 6. 目前ocs技术路线有哪些？ MEMS路线的优势在哪里 答：OCS技术呈现多元化发展态势，主要有MEMS方案、硅基液晶方案、压电陶瓷方案、硅光方案。 过去几年全光交换(OCS)交换机市场一直以MEMS方案为主流，占整个全光交换(OCS)交换机市场50%以上，MEMS方案基于微机电工艺，通过电压控制反射镜（整镜）转角实现光路切换。切换速度几十毫秒，响应较为迅速，插入损耗约3dB，信号传输损耗相对较小，主要应用于大规模数据中心，与高速光模块、光环形器或双向WDM器件构成一个高效率、低成本、高效益的大规模光交换系统。核心厂商主要有谷歌、Lumentum等。 7. 日本英唐微何时启动OCS的MEMS阵列方案研发？
--	---

	答：双方高度重视在MEMS阵列产品技术及制造层面的协同互补，目前已开展相关方案的沟通、探讨。 8. 光隆集成ocs业务的客户主要有哪些？量产的产品规格有哪些？ 答：光隆集成专注于光开关（OCS）相关技术研发，在机械式、MEMS微机械式、磁光式、电光式及波导式等多种控制方式上均有长期布局，光隆集成产品客户覆盖海内外市场。目前ocs产品中32×32、64×64、96×96的通道规格已达量产状态，128*128通道的正处于量产准备阶段，预计明年一季度到二季度之间有望量产。
风险提示	公司发行股份及支付现金购买资产事项涉及向深交所、中国证监会等相关监管机构的申请审核注册工作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。除此之外，本次交易存在被暂停、中止或取消的风险。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单	
日期	2025年12月1日